

H21年9月15日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第145委員会  
委員長 田島 道夫

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会  
第119回研究会 開催通知

日時：2009年10月16日(金) 13:00～17:35

会場：明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 3階 第1, 2会議室

[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)

東京都千代田区神田駿河台1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

テーマ「加工技術(研磨・洗浄・CMP技術)およびその評価技術の現状と将来」

－ 次世代の加工・評価技術を求めて －

世話人：原田博文(シルトロニック・ジャパン(株))、末岡浩治(岡山県立大学)、土肥俊郎(九州大学)

プログラム

13:00～13:05 開会の挨拶	総合司会：末岡浩治(岡山県立大学) 柿本浩一(九州大学)
13:05～13:10 はじめに	原田博文(シルトロニック・ジャパン(株))
13:10～13:50 基調講演「半導体 Si ウェーハの現状と将来動向 － 450mm大口径化・ナノボグラフィイー・エッジロールオフ問題と加工面評価の状況と課題 －」	檜山浩國((株)荏原製作所 技術・研究開発統括部)
13:50～14:30 「ディスクにおける CMP 技術 E Pad:湿式固定砥粒研磨パッド」	竹内雅哉(株式会社ディスク 営業技術本部)
14:30～15:10 「研磨における欠陥発生/研磨促進のメカニズム」	森永 均、玉井一誠((株)フジインコーポレーテッド)
15:10～15:30 休憩	
15:30～16:10 「先端洗浄技術の現状と今後」	宮本 誠(三菱電機 先端総研)
16:10～16:50 「LSI デバイスの進展とそれを支える CMP 技術」	山田洋平((株)日立製作所 マイクロデバイス事業部)
16:50～17:30 「ウェーハ ジェオメトリの計測と評価」	吉瀬正典(KLA Tencor ウェハー事業部)
17:30～17:35 おわりに	土肥俊郎(九州大学)
17:40～19:40 懇親会 (場所：リバティータワー23階 サロン燦)	

以上